(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-241781

(43)公開日 平成6年(1994)9月2日

技術表示箇所 (51)Int.Cl.⁵ 識別記号 庁内整理番号 FΙ G 0 1 B 21/30 Z 9106-2F G11B 9/00 9075-5D H 0 1 J 37/28 Z

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 8 頁)

(21)出願番号	特顯平5-49855	(71)出願人 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)2月17日	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者 鈴木 朝岳
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ
		ノン株式会社内
		(72)発明者 酒井 邦裕
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ
		ノン株式会社内
		(72)発明者 小口 高弘
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ
		ノン株式会社内
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 カンチレバー、及びこれを利用したカンチレバー型プローブ、及びカンチレバー型プローブを用 いた走査型トンネル顕微鏡、情報処理装置

(57)【要約】

【目的】 走査型トンネル顕微鏡や情報処理装置に用い られ、反りを低減し歩留まりを向上した薄膜積層体から なるカンチレバー状変位素子を提供する。

【構成】 圧電体膜と電極膜とを積層して形成されるカ ンチレバーの上下面に、圧電体膜よりも大きい線熱膨張 係数を有する金属膜を、カンチレバー中の残留応力を補 償するためのトリミング用部材として設けたカンチレバ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜を積層して形成されるカンチレバー に、該カンチレバー中の残留応力を補償するトリミング 用部材を設けたことを特徴とするカンチレバー。

【請求項2】 請求項1に記載のカンチレバーの自由端 部に、情報入出力用探針を設けたことを特徴とするカン チレバー型プローブ。

【請求項3】 請求項2に記載のカンチレバー型プロー ブを、同一基板上に複数設けたことを特徴とする集積化 カンチレバー型プローブ。

【請求項4】 請求項2または3に記載のカンチレバー 型プローブを用いたことを特徴とする走査型トンネル顕 微鏡。

【請求項5】 トンネル電流を用いて記録媒体に対して 情報の記録、再生、消去を行う情報処理装置において、 請求項2または3に記載のカンチレバー型プローブを用 いたことを特徴とする情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、トンネル電流検出装置 20 や走査型トンネル顕微鏡等に用いられるカンチレバー (片持ちばり) 状変位素子、及びこれを用いたカンチレ バー型プローブに関する。

【0002】さらには、上記カンチレバー型プローブを 備えた走査型トンネル顕微鏡、及び走査型トンネル顕微 鏡の手法により情報の記録、再生、消去等を行なう情報 処理装置に関する。

[0003]

【従来の技術】現在、走査型トンネル顕微鏡(以下、S TMと略す)の手法を用いて、半導体あるいは高分子材 料等の原子オーダー、分子オーダーの観察評価、微細加 I (E. E. Ehrichs, Proceedings of 4th International Con ference on Scanning Tunne ling Microscopy/spectrosc opy, '89. S13-3)、及び記録装置等の様々 な分野への応用が研究されている。

【0004】なかでも、コンピューターの計算情報や映 像情報等では大容量を有する記録装置の要求が益々高ま イクロプロセッサが小型化し、計算能力が向上したこと から記録装置の小型化が望まれている。

【0005】とれらの要求を満たす目的で、記録媒体と の間隔が微調整可能な駆動手段上に存在するトンネル電 流発生用プローブからなる変換器から電圧印加すること によって記録媒体表面の仕事関数を変化させ、記録書き 込みし、また、仕事関数の変化によるトンネル電流の変 化を検知して情報の読み出しを行う、最小記録面積が1 0 n m平方となる記録再生装置が提案されている。

*【0006】かかる装置においては、試料を探針で数n m~数μmの範囲で走査する必要があり、最近では、半 導体加工技術を利用したマイクロマシーニング技術

(K. E. Peterson, "Silicon as a Mechanical Material". P roceedings of the IEEE, 70 巻、420ページ、1982年)を用いて探針駆動機構 を微細に形成する試みがなされている。図12はマイク ロマシーニング技術により、Si基板上に圧電体バイモ 10 ルフからなるカンチレバーを形成した例である(T.

R. Albrecht, "Microfabricat ion of Integrated Scannin g Tunneling Microscope", P roceedings of 4th Interna tional Conference on STM/S TS '89 S10-2).

【0007】図12 (a) は、その斜視図であり、Si 基板上に2分割電極9a、9b-ZnO圧電体3'-中 電極8-2n0圧電体3-2分割電極2a、2bと積層 したカンチレバーを作り、その下のSi基板の一部を異 方性エッチングにより除去してSi基板の端部から片持 ちで支持されるように形成されている。

【0008】上記圧電体バイモルフからなるカンチレバ ーの先端には金属の探針6が接着などにより取りつけら れ、引き出し電極11を介してトンネル電流を検知す る。その際、図12(b)の断面図に示すようにカンチ レバーの上側の2分割電極2a、2bと中間電極8の間 にはさまれる2つの圧電体領域と下側の2分割電極9 a、9bとの間にはさまれた2つの圧電体領域の各々に 30 かける電圧を制御することによりカンチレバーを3次元 方向に動かすことができる。

【0009】マイクロマシーニング技術により形成され る探針駆動機構は微細にでき、記録再生装置の情報の書 き込み、読み出しの速度を向上させるに要求されるブロ ープの複数化を容易にすることが可能となる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる 装置においては電極及び圧電体の薄膜の積層を行うた め、各々の層の厚み及び応力を十分に制御しなければな っており、さらに、半導体プロセス技術の進展によりマ 40 らない。というのも、Si基板をエッチングして作製す るカンチレバーは各々の層の膜厚、応力に依存して反り が発生するからである。

> 【0011】図12に示すカンチレバーの反りは以下の 式(1)に比例している。とこで電極9、圧電体3'、 電極8、圧電体3、電極2の膜厚をt1、t2、t3、 t 4、t 5、応力をσ1、σ2、σ3、σ4、σ5とす

[0012]

 $\sigma 1 (A \times A - B \times B) + \sigma 2 \{C \times C - A \times A\} + \sigma 3 \{E \times E - C \times C\}$

 $+\sigma 4 \{F \times F - E \times E\} \cdots (1)$

CCC, A = 1/2 t 3 + t 2 B = 1/2 t 3 + t 2+t1 C=1/2t3 E=1/2t3+t4 F= 1/2t3+t4+t5

カンチレバーの反りの発生する原因として、各々の薄膜 の膜厚t1、t2、t3、t4、t5の誤差、膜の内部 応力の膜厚依存性(t2=t4の時σ2≠σ4)、積層 時の基板の材質及び表面粗度、積層することによる基板 の熱膨張係数の変化等が考えられる。

【0013】上記理由により発生するカンチレバーの反 10 りは、プローブと媒体との適切な位置関係を阻害し、ト ンネル電流の生じるに必要な間隔を保つことを困難にす る。

【0014】以上のような従来例の問題点に鑑み、本発 明は反りの原因となっている残留応力を補償して反りを 低減し、歩留まりを飛躍的に向上したカンチレバーを提 供することを目的とする。

【0015】また、本発明の他の目的は、このカンチレ バーを利用したプローブを用いた走査型トンネル顕微鏡 及び情報処理装置を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に成された本発明は、薄膜を積層して形成されるカンチ レバーに、該カンチレバー中の残留応力を補償するトリ ミング用部材を設けたことを特徴とするカンチレバーで あり、上記カンチレバーの自由端部に、情報入出力用探 針を設けたことを特徴とするカンチレバー型プローブで あり、上記カンチレバー型プローブを、同一基板上に複 数設けたことを特徴とする集積化カンチレバー型プロー ブであり、上記カンチレバー型プローブまたは上記集積 30 化カンチレバー型プローブを用いたことを特徴とする走 査型トンネル顕微鏡であり、更には、トンネル電流を用 いて記録媒体に対して情報の記録、再生、消去を行う情 報処理装置において、上記カンチレバー型プローブまた は上記集積化カンチレバー型プローブを用いたことを特 徴とする情報処理装置である。

【0017】本発明のカンチレバーは、例えば圧電バイ モルフ構造からなる駆動用部材として、また半導体ピエ ゾ素子構造からなるセンシング用部材として用いられ、 例えばシリコン単結晶基板上にマイクロマシニング技術 40 を用いて製造される。

【0018】上記カンチレバーは薄膜積層体であって、 各薄膜層は半導体等からなる圧電体層や、導電体からな る電極層である。

【0019】本発明において用いられる圧電体層の材料 としては、ZnO, AlN, Ta,O,, PZT, PL ZT、PVDFなどがあり、特に材料が限定されること はない。

【0020】また電極層の材料としては、Au, Al, Pt,Ag,Cuなど単体の金属、Au/Cr,Pt/ 50 (6)次に、薄膜積層体であるカンチレバー中の残留応

Tiなどの複層の電極合金、導電性化合物等を用いると とができ、その材料は特に限定されない。

【0021】本発明に係るトリミング用部材は、上記各 種薄膜層を積層することによりカンチレバー中に残留す る応力によって生じたカンチレバーの反りを許容範囲内 になるまで低減させるためのものである。

【0022】トリミング用部材はカンチレバーの片面あ るいは両面に設けることができ、その材料としては、圧 電体層と異なる線熱膨張係数を有するものを用いること ができ、例えば金属膜のように線熱膨張係数の大きいも のや、SiO₂のように線熱膨張系数の小さいものを用 いるととができる。

【0023】本発明のカンチレバー型プローブにおい て、前記情報入出力用探針は、本発明のカンチレバーの 自由端部に例えばPt、Rh、Wなどの金属片を接着す るか、あるいは金属膜を堆積、加工して針状に形成する ことができるが、この方法に限定されるものではない。 [0024]

【実施例及び作用】以下、本発明を実施例により具体的 20 に説明する。

【0025】実施例1

本実施例は本発明のカンチレバー型プローブを作製した ものであり、図1にその構成図を示す。

【0026】先ず、図2~図6を用いて本実施例におけ る製造工程を説明する。

(1)図12に示した従来のカンチレバーの製造方法と 同様に、Si基板上に(2分割)電極9-ZnO圧電体 3'-中電極8-ZnO圧電体3-(2分割)電極2及 び引き出し電極11を積層した後、Si基板1の一部を 異方性エッチングにより除去しSi基板の端部から片持 ちで支持されるカンチレバーを形成した。更に、このよ うにして形成した圧電バイモルフ構造のカンチレバーの 上,下面に絶縁層4,4.としてプラズマCVDを用い てSiO,を5000A厚形成した(図2参照)。尚、 本実施例では電極2, 8, 9, 11はいずれもAuを用 しった。

(2)次に、絶縁層4、4°をフォトリソグラフィ等を 用いてパターニングし不要部分を除去した(図3参

(3)次に、カンチレバーを200℃~300℃に加熱 した状態で両面にトリミング用部材5,5'としてA1 膜を真空蒸着法などで1μm厚形成した(図4参照)。 (4)次に、トリミング用部材5,5'をフォトリソグ

ラフィ等を用いてバターニングし不要部分を除去した (図5参照)。

(5)次に、カンチレバーの自由端部に、₩からなる探 針6を接着しカンチレバー型プローブを完成した(図6 参照)。

力による反りを低減するために、レーザートリミング装置10を用いてトリミング用部材5の一部(図中の7)を除去した(図7参照)。

5

【0027】本実施例ではトリミング用部材としてA1 膜を使用しているので、圧電体層(ZnO)と比較して線熱膨張係数が大きく(A1の線膨張率:30、2×E-6, ZnOの線膨張率:4×E-6)、200~300℃に加熱した状態で形成されたトリミング用部材は、常温ではカンチレバーを縮ませる方向に働いている。そのためトリミング用部材をトリミングして除去すること 10により、トリミング面と反対側にカンチレバーが反る方向に補正されるととになる。トリミングが過大になり反りが反対側になった場合には反対面をトリミングすることで再補正が可能である。

【0028】本実施例において作製したカンチレバーの幅は 40μ m、長さは 200μ mであり、トリミング前(図6)のカンチレバー先端の反りは 2μ mであった。また、トリミング用部材をトリミングすることにより、容易にカンチレバー先端の反りを 0.5μ m以下とすることができた。

【0029】実施例2

本実施例は図8に示されるような本発明のカンチレバー 型プローブを作製したものである。

【0030】本実施例では、カンチレバーの片面(図の上面)のみにトリミング用部材を形成した以外は実施例1と同様であり、トリミングが過大になり反りが反対側になった場合に、その再補正をすることはできないが、製造工程が簡単になる。

【0031】本実施例においても、カンチレバーの幅は 40μ m、長さは 200μ mであり、トリミング前のカンチレバー先端の反りは 2μ mであった。また、トリミング用部材5の一部(図中の7)をトリミングすることにより、容易にカンチレバー先端の反りを 0.5μ m以下とすることができた。

【0032】実施例3

本実施例は、図9に示されるように実施例1で作製した本発明のカンチレバー型プローブを同一のシリコン基板上に複数個作製し、集積化カンチレバー型プローブを作製したものであり、更には、この集積化カンチレバー型プローブを用いてSTM装置並びに情報処理装置を作製 40したものである。

【0033】本実施例の集積化カンチレバー型プローブ12は、実施例1で説明した作製方法においてフォトリソグラフのパターンを拡張するだけで同時に作製するととができ、組立て作業は必要ない。このように同一の基板上へ複数のカンチレバーを一括して形成しているため、寸法精度が非常に高く、各カンチレバー間のばらつきも非常に小さく抑えることができる。

【0034】また基板としてSi単結晶を用いることにより、トランジスタやダイオード等の半導体素子も同一 50

基板上へ集積化することも可能となり、トンネル電流の 増幅回路やカンチレバー駆動用のアンプ等を一体化する ことができる。

【0035】上記集積化カンチレバー型プローブの各カンチレバーに設けられたトリミング用部材に対して、実施例1と同様にしてレーザートリミングを行ったところ、容易に各カンチレバーの反り量を均一にすることができた。

【0036】次に上記集積化カンチレバー型プローブを 用いてSTM装置を作製した例について述べる。図10 にこの装置のブロック図を示す。本装置では集積化カン チレバー型プローブ12にて試料13に探針6を近づけ たのち(図のZ方向)、試料13面内のx方向、y方向 をx-yステージ14にて走査し、探針6と試料13に バイアス電圧印加回路15より電圧を加え、そのとき観 察されるトンネル電流をトンネル電流検出回路16で読 み出し、像観察を行なう。試料13と探針6の間隔制御 とx-yステージ14の駆動制御は駆動制御回路17に て行なう。これら回路のシーケンス制御はCPU18に 20 て行なう。

【0037】具体的には、探針6を試料13の表面へ接 近させたとき、との表面が導電性を持つ場合、探針6と 試料13との距離が数nm程度まで近づくと探針6と試 料13との間にトンネル電流が流れる。とのトンネル電 流は、探針6の先端と試料13との距離により指数関数 的に変化するため、このトンネル電流をトンネル電流検 出回路16で取出して増幅を行ないカンチレバー部の駆 動電圧にフィードバックをかけることにより、探針6の 先端と試料13の表面までの距離を一定に保つことがで きる。この様な状態でカンチレバー部をx、y方向に微 小に変位させることにより、フィードバック電圧の変化 により極微小表面の凹凸を観察することが可能である。 【0038】また、図には示していないが、x-yステ ージ14による走査の機構としては、円筒型ピエゾアク チュエータ、平行バネ、作動マイクロメータ、ボイスコ イル、インチウォームなどの制御機構を用いて行なう。 【0039】 この装置にて、試料13 にHOPG (グラ ファイト) 板を用いて表面観察を行なった。バイアス電 圧印加回路 15 にて 200 m V の直流電圧を探針 6 と試 料13の間に加えた。この状態で試料13に沿って探針 6を走査してトンネル電流検出回路16を用いて検出さ れる信号より表面観察を行なった。スキャンエリアを $0.05 \mu m \times 0.05 \mu m$ として観察したところ、す べての探針において良好な原子像を再現性良く得ること ができた。このようにSTMの原理による動作が確認さ れ表面観察動作が確認された。

【0040】また、図11に先の集積化カンチレバー型 プローブを用いた、情報の記録・再生等を行なえる情報 処理装置の模式図を示す。

【0041】同図において、19は電圧印加により抵抗

値が変化する記録層、20は金属電極層、21は記録媒 体基板である。14はXYステージ、12は本発明によ る集積化カンチレバー型プローブ、22は集積化カンチ レバー型プローブ12の支持体、23は集積化カンチレ バー型プローブ12を2方向へ粗動するためのリニアア クチュエータ、24,25はXYステージ14をそれぞ れX、Y方向へ駆動するリニアアクチュエータ、26は 記録再生用のバイアス回路である。16はトンネル電流 検出回路、27は集積化カンチレバー型プローブ12を Z方向に移動させるためのサーボ回路であり、28はア 10 クチュエータ23を駆動するためのサーボ回路である。 29は個々のカンチレバーを微小変位させるための駆動 回路であり、31はXYステージ14の位置制御を行な う駆動回路である。32はこれらの操作を制御するCP Uである。30はアクチュエータ23の駆動回路であ る。

【0042】とのようなシステムを用い上述のSTMと 同様の動作を行なうことにより、nmオーダーの記録密 度の大容量・高密度な記録、再生、消去を行なうことが 可能となり、またプローブを多数集積化し、それらを同 20 1 シリコン基板 時に走査するため、高速度の記録再生を行なうことがで きた。

[0043]

【発明の効果】以上説明した様に本発明は以下の効果を

- (1) 本発明のカンチレバー及びカンチレバー型プロー ブは反りを低減できる構成を有することにより、許容反 り量に対して歩留まりの向上ができると共に、任意の反 り量に製造することもでき、幅広い用途が期待されるも のである。
- (2) 本発明のカンチレバー型プローブあるいは集積化 カンチレバー型プローブを用いた本発明の走査型トンネ ル顕微鏡は、高速で信頼性の高い像観察を安定して行う ことができる。
- (3) 本発明のカンチレバー型プローブあるいは集積化 カンチレバー型プローブを用いた本発明の情報処理装置 は、nmオーダーの記録密度をもつ大容量・髙密度の装 置となり、かつ、高速で記録再生等を行うことができる とともに、エラーの発生率を小さくすることができ信頼 性の高い装置となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカンチレバー型プローブの一実施例を 示す構成図である。

【図2】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図3】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図4】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図5】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図6】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図7】図1のカンチレバー型プローブの製造工程を説 明するための図である。

【図8】本発明のカンチレバー型プローブの他の実施例 を示す構成図である。

【図9】本発明の集積化カンチレバー型プローブの一実 施例を模式的に示した図である。

【図10】図9の集積化カンチレバー型プローブを用い たSTM装置のブロック構成図である。

【図11】図9の集積化カンチレバー型プローブを用い た情報処理装置のブロック構成図である。

【図12】従来例のカンチレバー型プローブの構成図で ある。

【符号の説明】

2, 2a, 2b 上電極

3. 3' 圧電体

4, 4' 絶縁層

5. 5' トリミング用部材

6 探針

7 トリミングによる加工溝

8 中電極

9, 9a, 9b 下電極

10 レーザートリミング装置

30 11 引き出し電極

12 集積化カンチレバー型プローブ

13 試料

14 X-Yステージ

15 バイアス電圧印加回路

16 トンネル電流検出回路

17 駆動制御回路

18 CPU

19 記録層

20 金属電極層

40 21 記錄媒体基板

22 支持体

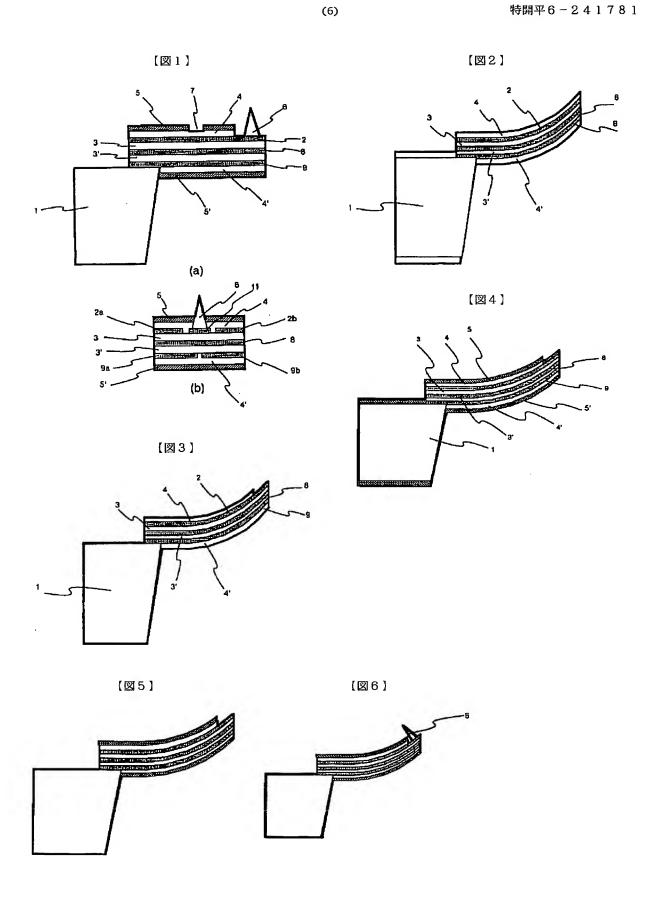
23~25 リニアアクチュエーター

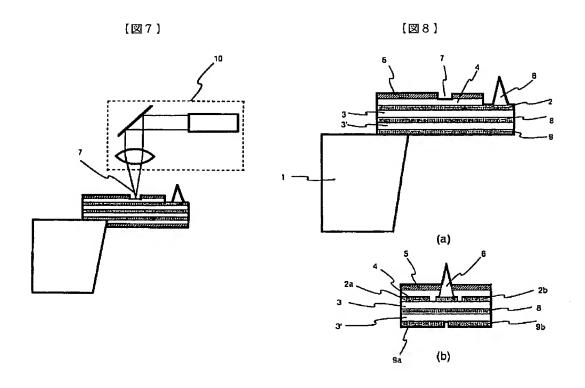
26 バイアス回路

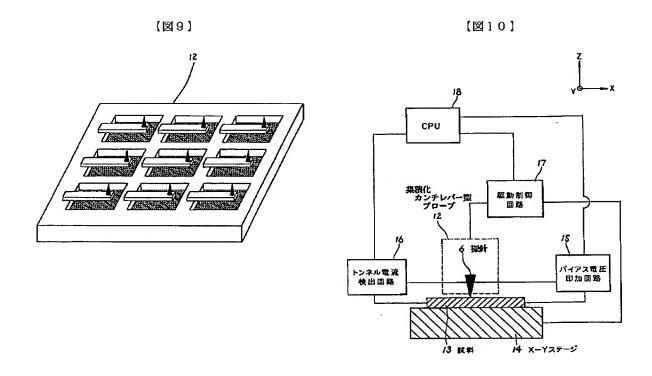
27, 28 サーボ回路

29~31 駆動回路

32 CPU







フロントページの続き

(72)発明者 山野 明彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

(72)発明者 紫藤 俊一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内